

NC273LT SOLDURA EN PASTA NO CLEAN

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para aplicaciones a baja temperatura
- Cumple la norma RoHS
- Mejora el mojado para aleaciones con bismuto
- Minimiza la formación de bolas de soldadura
- Vida en el estencil > 8 horas

DESCRIPCIÓN

El revolucionario sistema activador de la soldadura en pasta para bajas temperaturas NC273LT de AIM, mejora el desempeño del mojado de las aleaciones que contienen bismuto, ofreciendo acabados que cumplen con la norma RoHS. La NC273LT ofrece larga vida de estencil, excelente eficiencia de transferencia y reduce las probabilidades de generación de bolas de soldadura, típicas en procesos donde se utilizan aleaciones con alto contenido de bismuto. Cuando la exposición térmica durante el proceso es una limitación, la NC273LT es un excelente reemplazo, compatible con la norma RoHS. Las soldaduras en pasta con contenido de bismuto disminuyen el pico máximo en el perfil de reflujo a temperaturas tan bajas como 170°C-185°C (338°F-365°F). Al igual que con cualquier aleación que contenga bismuto, el ensamble debe ser completamente libre de plomo.



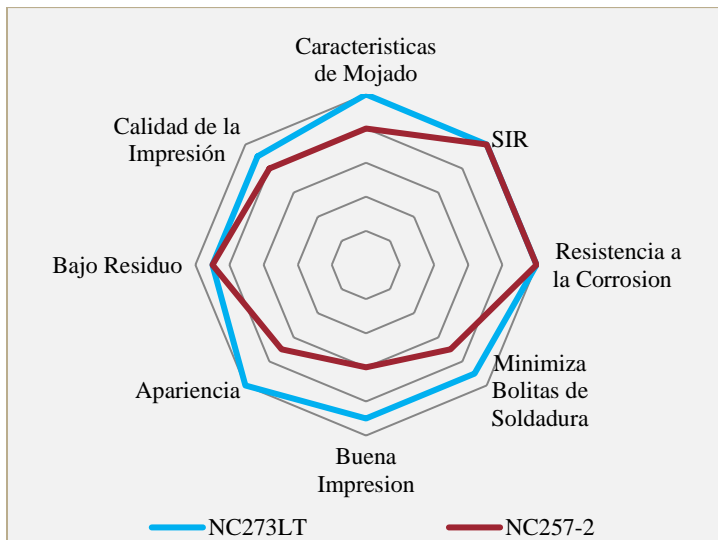
MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PARÁMETRO	TIEMPO	TEMPERATURA
Vida útil de pasta cerrada y congelada	6 meses	< 0°C (32°F)
Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	4 meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	2 semanas	< 25°C (< 77°F)

No agregue pasta usada al contenedor de pasta nueva. La pasta usada deberá ser almacenada por separado y la pasta nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapón. Una vez abierta, la vida útil de la soldadura en pasta dependerá de la aplicación y el entorno. Consulte la guía de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de NC273LT para información específica del producto.

LIMPIEZA

Los residuos de NC273LT pueden permanecer en el ensamblaje después del reflujo y no requieren limpieza. Cuando la limpieza es obligatoria, AIM ha trabajado estrechamente con socios de la industria para garantizar que los residuos de NC273LT puedan eliminarse eficazmente con agentes defluxantes comunes. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre compatibilidad de limpieza.

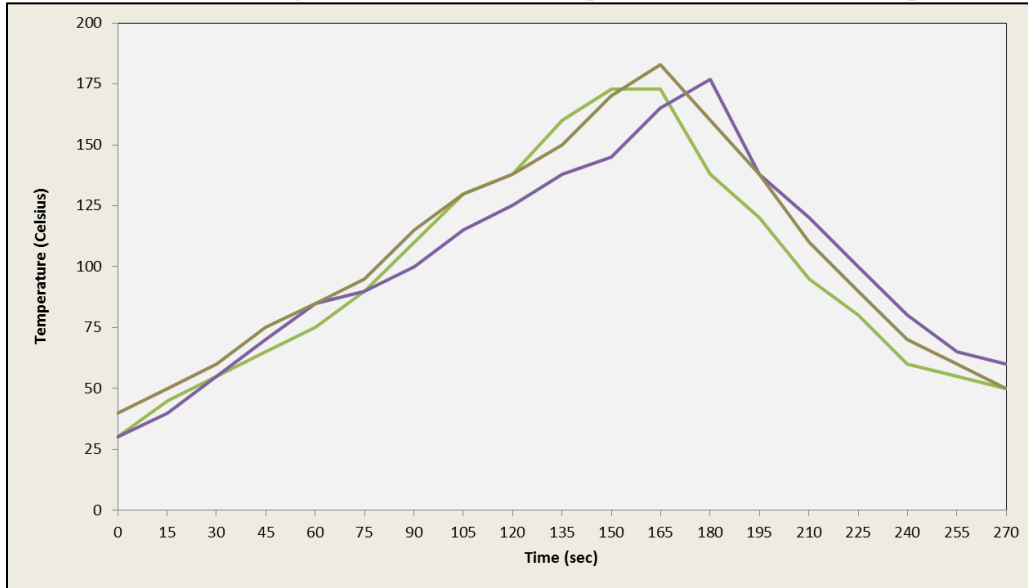


*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

PERFIL DE REFLUJO

El área sombreada de abajo indica la ventana de proceso del perfil, su perfil puede diferir. Las limitaciones de los componentes, la eficiencia del horno, el tamaño/masa de la placa, el tipo de componente y la densidad influirán en el perfil de reflujo optimizado. Estas recomendaciones son orientativas. Póngase en contacto con AIM para obtener asistencia sobre perfiles.



ÍNDICE DE CALENTAMIENTO 1-3°C / SEG. MAX.	RAMPA A 100°C (212°F)	RAMPA DE 100°C-140°C (212°F- 284°F)	RAMPA A PICO 170°C-185°C (338°F- 365°F)	TIEMPO SOBRE LIQUIDO 138°C (280°F)	RAMPA DE ENFRIAMIENTO ≤ 4°C/SEG	TIEMPO DE INICIO AL PICO MÁXIMO
	≤ 75 Seg	30-60 Seg	45-75 Seg	50-80 Seg	45 ± 15 Seg	2.75-3.5 Min





IMPRESIÓN

CONFIGURACIÓN INICIAL RECOMENDADA – VARIA DE ACUERDO AL TIPO Y DISEÑO DEL PCB O PAD	
Parámetro	Valor Inicial Recomendado
Presión de la espátula	0.9 -1.5 libra/pulgada de espátula
Velocidad de la espátula	0.5 - 6 pulgada/segundo
Distancia de Separación (Snap-off)	En contacto - 0.00 mm
Distancia de Desprendimiento entre PCB y estencil	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Desprendimiento entre PCB y estencil	3 - 20 mm/Segundo

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

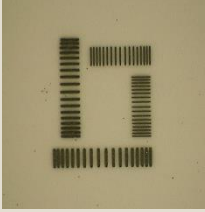

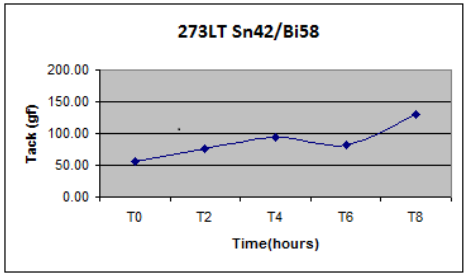

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

DATOS DE PRUEBAS

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO	
Clasificación de IPC	J-STD-004 3.2.3.1	ROLO	
Clasificación de IPC	J-STD-004B 3.3.1.2.1	ROL1	
NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO	IMAGEN
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Fundente.	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Antes</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Después</p>  </div> </div>
Contenido de Haluro(s) por Método de Cromatografía Iónica	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.23% Cl: 0.0% Valor Típico	
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruros	
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	
Contenido de Sólidos No Volátiles en el Flux	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	3.17 Valor Típico	
Índice de Acidez del Flux	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	159.4 mg KOH/ g flux	
Gravedad Especifica	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.98	

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO	IMAGEN												
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	Fórmula para Imprimir: 750kcps Valor Típico Fórmula para dispensado: 400kcps Valor Típico													
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Gris, Suave, Cremosa													
Prueba colapsamiento de la Soldadura en Pasta (Slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA													
Prueba de Esfera de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA													
Prueba de retención (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	55.3gf Típico	 <table border="1"> <caption>273LT Sn42/Bi58 Tack Data</caption> <thead> <tr> <th>Time (hours)</th> <th>Tack (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T0</td> <td>~50</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td>~75</td> </tr> <tr> <td>T4</td> <td>~95</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>~80</td> </tr> <tr> <td>T8</td> <td>~130</td> </tr> </tbody> </table>	Time (hours)	Tack (gf)	T0	~50	T2	~75	T4	~95	T6	~80	T8	~130
Time (hours)	Tack (gf)														
T0	~50														
T2	~75														
T4	~95														
T6	~80														
T8	~130														
Prueba de Mojado (Wetting)	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA													

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.